

DO	CUMEN	IT No.	TITLE	PRO	DUCT SPECI	FICATIONS			PAGE	
	KQS	902		李行	品、仕类	·亲	•		1/6	
BAG	CKGRO			-						
-	J1(U1(U									
1		一般事項	· ·							
1.1	Applic	ation 適用		ition is applied to ドは、キートップなしのタ		/hich have no keyto 新田士ス	p.			
1.2	Opera	iting temperature				umidity,normal air p	ressure 常湿·常	<b>E</b> ) .		
ı		ge temperature r				humidity,normal air				
1.4	Test	conditions 試験					easurements and	tests are as follows.		
				別定は特に規定がな			o\	•	•	
			Normal i	temperature 常 numidity 常		rature 温度 5~35℃ umidity 湿度 25~8				
Ì	•			air pressure 常		sure 気圧 86~106				
						be conducted at t	he following condi	tions.		
				とに疑義を生した場 temperature 温	台は以下の基準7 度: 20±2℃	で服で行う。			•	
		-	Relative		度: 60~70%				* .	
	•		Air press		圧: 86~106k	Pa				
2 4					•					
		nce, style and of rance 外観	mensions 外観、形状 Th		facts that affact	the serviceability o	f the product			
	, ,,,,,,,,,,			能上有害な欠陥が			i ule produce			
2.2	Style	and dimensions	形状、寸法 Refer	to the assembly o	irawings. 製品図	による。				•
2 1		and the state of t	W-# T M. £			_				
3. 1	уре от	actuating 動作	形式 <u>Tactile fe</u>	segnack 3774	ールフィードバック	_			•	
4. C	ontact	arrangement 🗓								
			. (Details	of contact arrange	ement are given i	n the assembly dra	wings 回路の記	詳細は製品図による).		
5. R	atings	定格				•				
		um ratings 最大		V DC <u>20 m</u> A			•	* •	•	
5.2	Minimu	um ratings 最小	定格1_	V DC <u>10 μ</u> Α	L	•	-			
6. El	ectrical	specification 2	電気的性能					t .		
	Ita	ems 項目	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T	5-4 EQ. 42	E. 10L			du of the two	
6.1		act resistance	Applying a below sta	Test conditions	試験 絫		ill he	Oriteria 500 mΩ Max.	判定基準	
		虫抵 抗	made,			, mesoarements one				
		-	スイッチ操作部中央に丁							
			(1) Depression	押压力: <u>3.1</u>						
			(2) Measuring meth			contact resistance ethod at 5VDC 10m				
						抵抗計、又はDC5V				
6.2	Insula	ation	Measurements shall	be made following	the test set fort	h below:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del>-</del>	
	resist		下記条件で試験を行	った後、測定する。						
	艳葙	<b>提 技</b>	(1) Test voltage	印可電圧: <u>100</u>				100 MΩ Min.		
	İ		(2) Applied position			ind it there is a me minals and ground(i				
						ムがある場合は、端				
				金	属フレーム間					
6.3	Volta	ge proof	Measurements shall	be made following	the test set forti	n below:		There shall be no by	reakdown.	
	耐 電 圧 下記条件で試験を行っ									
			(1) Test voltage (2) Duration	印可健E:						
			(3) Applied position			And if there is a m	etal			
			,	fr	ame, between ter	minals and ground(t	rame)			
					i于间,金属フレー :属フレーム間	ムがある場合は、端	±€			
	i		,		(A)					
		:								
	]									
							İ		•	
	-									
	, <u> </u>			1	<del></del>	· 1	<u></u>	1		
				· ·				DSGD. ASSO,	रे० २००३	
								<u> </u>	Banna	
			W-107-113-113-113-113-113-113-113-113-113-11					CHKD. Sep. 30	.2003. ĐG1	
								1	toha	
		4-0-						APPD. Cop. 3	0.2003. DG7	
	ev.	初版.1 st.edition		Oct. 18 1995	Y. Ono	Y.Ono	J.Tsutsumi		1	
~u=	SYMB	. BA	CKGROUND	DATE	APPD	CHKD	DSGD	a t /.	10210	_

DOC	UMENT No. KQS-902	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE . 2/6	
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria	判定基準
6.4	Bounce パウンス	Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use (3 to 4 operations per s.),bounce shall be tested at "ON" and "OFF". スイッチ操作部の中央部を通常の使用状態(3~4回/秒)で軽く打鍵し、ON時及びOFF時のパウンスを測定する。	ON bounce: 10 OFF bounce: 20	
	-	Switch Oscilloscope オシロスコープ		
		"ON"		
7. Me	echanical specification	機械的性能		
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria	判定基準
7.1	Operating force 作動力	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then gradually increasing the load applied to the center of the stem, the maximum load required for the switch to come to a stop shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に徐々に荷重を加え、操作部が停止するまでの最大荷重を測定する。	1.57_±_0.49_N	
7.2	Travel	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and	0.25 +0.2/-0.1 mm	
,,,,	移動量	then applying a below static load to the center of the stem, the travel distance for the switch to come to a stop shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に以下の静荷重	<u> </u>	
		を加え、操作部が停止するまでの距離を測定する。 (1) Depression 押圧力: <u>3.14</u> N	·	• •
7.3	Return force 復帰力	The sample switch is installed such that the direction of switch operation is vertical and upon depression of the stem in its center the whole travel distance the force of the stem to return tot its free position shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部を全移動量押圧後、操作部が復帰する力を測定する。	_0.20 N Min.	· .
7.4	Stop strength ストッパー強度	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then a below static load shall be applied in the direction of stem operation.  スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、スイッチの操作方向へ以下の静荷重を加える。  (1) Depression 押圧力: 29.4 N (2) Time 時間: 60 s.	There shall be no mechanically and e 機械的、電気的に基	lectrically.
7.5	Stem strength ステム抜去強度	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then the maximum force to withstand a pull applied opposite to the direction of stem operation shall be measured.  スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部の操作方向とは反対方向に操作部を引っ張って抜けない力である。	4.9N	
8. En	vironmental specification	耐候性能	1	
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria	判定基準
8.1	Resistance to low temperatures 耐寒性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後、常温、常湿中に1時間放置後測定する。  (1) Temperature 温 度:30 ± 2 °C  (2) Time 時間:96 h  (3) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Item 6. Item 7.1 Item 7.2	·
8.2	Heat resistance 耐熱性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後、常温、常湿中に1時間放置後測定する。  (1) Temperature 温 度: 80 ± 2 °C  (2) Time 時間: 96 h	Item 6. Item 7.1 Item 7.2	
	-			

KQS-90	ļ	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書		PAGE 3/6
•				
items 3.3 Moisture resistance 耐湿性	tempe 次の記 (1) - (2) 7 (3) i	Test conditions 試験条件 wing the test set forth below the sample shall be left in normal erature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 試験後、常温、常湿中に1時間放置後測定する。 Temperature 温度: 60 ± 2 °C Time 時間: 96 h Relative humidity 相対湿度: 90 ~ 95 % Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Criteria  Contact resistance $\frac{1000 \text{ m}}{\Omega}\Omega$ Max.  Insulation resistance  10 M $\Omega$ Min.  Item 6.3  Item 6.4  Item 7.1	
3.4 Change of temperatur 温度サイク	e to sta	below cycles of following conditions, the switch shall be allowed and under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and urement shall be made. Water drops shall be removed.	Item 7.2  Item 6. Item 7.1 Item 7.2	
·	ただし	条件で以下回数のサイクル試験後、常温常湿中に1時間放置し測定する。 水滴は取り除く。 A = <u>60</u> ℃ 		
	В	$C = \frac{2}{2} h$ $D = \frac{1}{1} h$ $E = \frac{2}{1} h$ $F = \frac{1}{1} h$ (1) Number of cycles		
		C D E F サイクル数: <u>5</u> cycles		
. Endurance spec				
Items 1.1 Operating li 動作寿	前 Measu 市 下記第 (1)	Test conditions 試験条件  irrements shall be made following the test set forth below.  条件で試験を行った後、測定する。  5 VDC _ 5 mA resistive load 抵抗負荷  the of operation 動作速度: 2 to _ 3 operations per sec. 回/秒  ppression 押圧力: 2.06 N Max  teles of operation 動作回数: 100,000 cycles 回	Criteria  Contact resistance 接 1000m Ω Max. Insulation resistance: 10 MΩ Min. Bounce パウンス(Item ON bounce: 10 n OFF bounce: 20 n Operating force 作動: -30 ~ +30 % 初期値に対して Item 6.3	絶繰抵抗(Item 6.2): 6.4): ns Max. ns Max. 力(Item 7.1):
1			Item 7.2	
2 Vibration resistance 耐振性	下記条 (1)Vibr (2)Tota (3)Swe (4)Meti 掃。 (5)Dire	rements shall be made following the test set forth below.  会件で試験を行った後、測定する。 ation frequency range 振動数範囲: 10 ~ 55 Hz al amplitude 全振幅: 1.5 mm approx 1 min 約1 分 approx 1 min 約1 分 approx 1 min 約1 分 approx 1 min 約1 分 approx 1 min 約1 分 approx 2 min approx 3 min approx 4 min approx 4 min approx 5 min approx 5 min approx 5 min approx 6 min approx	Item 6. Item 7.1 Item 7.2	
resistance	下記条 (1)Vibr (2)Tota (3)Swe (4)Met 指 (5)Dire 振 (6)Dura Measur 下記条 (1)Acci (2)Test	##で試験を行った後、測定する。 ation frequency range 振動数範囲: 10 ~ 55 Hz al amplitude 全振幅: 1.5 mm ### 「持引の割合: 10-55-10 Hz Approx_1 min 約1 分 hod of changing the sweep vibration frequency: Logarithmic or uniform 対数又は一様掃引 ction of vibration: Three mutually perpendicular directions, including 助の方向 the direction of the travel スイッチ操作方向を中心とした垂直3方向	Item 6. Item 7,1	

OCUMENT No. KQS-902	TITLE PRODUCT SP 製品仕		PAGE 4/6				
). Soldering conditions =	<b>半田付条件</b>						
Items 項目 Items 項目							
手半田	以下の条件にて実施して下さい。						
	(1)Soldering temperature 半田温度: 360	_					
	(2)Continuous soldering time 連続半田時間: 3 (3)Capacity of soldering iron 半田コテ容量: 20						
	(4)Excessive pressure shall not be applied to the t						
	端子に異常加圧のないこと (5)Safeguard the switch assembly against flux pene スイッチの上面からフラックスが浸入しない様にして						
.2 Automatic flow soldering		ed for soldering adhere to the following conditions:					
オートディップ半田	items 項目	Soldering conditions 半田付け	<b>计条件</b>				
	(1)Preheat temperature プリヒート温度	110 °C Max.					
	The remaining of the state of t	(Ambient temperature of printed circuit board on soldering side) (プリント基板の半田付け面の周囲の温度)					
	(2)Preheat time プリヒート時間						
	(3)Flux foaming フラックス発泡量	To such an extend that flux will be kept flush with t	he printed circuit				
		board's top surface on which components are mounted	d. Preparatory flux must				
		not be applied to that side of printed circuit board of mounted and to the area where terminals are located	•				
		プリント基板の部品実装面上にフラックスが周囲から上が					
		プリント基板の部品実装面上及びスイッチ端子部に予備	フラックスが塗布されていな				
	(4)Soldering temperature 半田温度	いこと。 					
	(5)Duration of solder immersion 半田浸漬時間	5 s. Max.	and the state of t				
	(6)Allowable frequency of soldering process	2 times Max.					
	半田回数	Twice soldering would be dipped after the temperatur	e goes down to a normal				
		temperature. 2回目を行う場合は、スイッチが常温に戻ってから行うこと					
		(In case of 1 time MAX, the above remarks don't app (1回以内の場合は、上記の内容は適用しない。)					
	(7)Recommended printed circuit board 推奨プリント基板	Printed circuit board shall be paper phenol with single thickness of that shall be 1.6mm. プリント基板は紙フェノール片面パターンの板厚1.6mm					
·	(8)Recommended flux	Soldering flux shall be "MH-820V", "CF220" (TAMU					
	推奨フラックス	equivalent (Specific gravity of soldering flux shall be 20°C.)	more than 0.83 at				
		フラックスについては、田村製作所製MH−820V又はC てください。(20°C換算でフラックス比重0.83以上)	<u>F220</u> 相当品を使用し				
	(9)Other precaution その他注意事項	Safeguard the switch assembly against flux penetratio スイッチの上面からフラックスが浸入しない様にして下さ	=				
-							
1							
	·	•					
		•					
	•						
	1						
1	1						

DOCUMENT No. KQS-902	I	T SPECIFICATIONS  - 仕 排 書	PAGE 5/6

【Precaution in use】ご使用上の注意

A. General 一般項目

A1. This product has been designed and manufacturfd for general electronic devices, such as audio devices, visual devices, home electronics, information devices and communication devices. In case this product is used for more sophisticated equipment requiring higher safety and reliability, such as life support system, space & aviation devices, disaster prevention & security system, please make verification of comformity or check on us for the details

本製品はオーディ機器、映像機器、家電機器、情報機器、適信機器などの一般電子機器用に設計・製造したものです。生命維持装置、宇宙・航空機器、防災・防犯機器などの高度な安全性や信頼性が求められる用途に使用される場合は、責社にて適合性の確認を頂くか、当社へご確認ください。

- A2. This product is designed and manufactured assuming that it is to be used with the resistance for direct current. If you use other kinds of resistance (inductive (L) or capacitive (C)), please let us know beforehand.

  本製品は直流の核抗負荷を想定して設計・製造されています。その他の負荷(誘導性負荷(L))、容量性負荷(C))で使用される場合は、別途ご相談ください。
- B. Soldering and assemble to PC board process 半田付、基板実装工程
- B2 Conditions of soldering shall be confirmed under actual production conditions. はんだ付けの条件の設定については、実際の量産条件で確認されるようお願いします。
- B3. If you use a through-hole PCB or a PCB with smaller thickness than recommended, please previously check the soldering conditions adequately, because there is larger heat stress.

スルーホールのプリント基板及び推奨板厚より薄い基板をご使用される場合は推奨基板よりも熱ストレスの影響が大きくなりますので半田付条件については事前に 十分な確認をして下さい。

- B4. If you use a PCB with smaller thickness than recommended, please pay enough attention to rising of switches when mounted. 推妥板厚より薄い基板をご使用の際は、実装時のスイッチ浮きに十分ご注意下さい。
- B5. When the switch is mounted on a printed circuit board, the case shall be held. And insert the product body to the specified fixing plane and fix it giving it the horizontal position. If it isn't fixed horizontally, it may cause malfunction.

  本スイッチをプリント基板へ取り付ける場合は、ケースを持って行って下さい。製品本体を規定の取付面まで挿入して水平になるように取り付けてください。水平にならないまま取り付けますと、動作不良の要因となります。
- 86. If the stem is given stress from the side, it may result in damages to switch functions. Therefore please handle it with extreme care. When the switch is carried, any shock shall not be applied to the stem. ステムに構からの力が加わりますと、スイッチの機能破壊につながる危険性がありますので取扱いは十分注意して下さい。 移動する場合はステムに衝撃が加わらない様に注意して下さい。
- B7. Do not press the stem but the switch body when you correct rising of the switch mounted on PCB. 基板実装後スイッチの浮きを修正する際は、スイッチのステムを押さずにスイッチ本体を押す様にして下さい。
- B8.Conditions for thermosetting oven. 熱硬化炉条件

When the board on which the switch is mounted has to be put in the oven so as to harden adhesive for other parts, the conditions shall be 160°C at max. (on the parts mounted side of PCB), and not longer than 2 minutes. スイッチを取り付けた後、他部品の接着剤硬化等のため熱硬化炉を通す場合、条件は160°C以下(基板部品面の温度)、2分以内として下さい。

B9.Take most care not to let flux foam penetrate the switch when you perform auto-dip soldering, which may sometimes produce too much foam. Take special care when you have LED or grounded terminals.

オートディップの場合フラックスの発泡量過多によりフラックスがスイッチ内部に浸入する場合が有りますので十分にご注意ください。 (LED付・アース端子付の場合は特にご注意下さい)

- C. Washing process 洗浄工程
- C1. Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. 半田付け後, 溶剤等でスイッチを洗浄しないでください。
- D. Mechanism design(switch layout) 機構設計
- D1. The dimensions of a hole and pattern for mounting a printed circuit board shall refer to the recommended dimensions in the engineering drawings. プリント基板取付穴及びパターンは、製品図に記載されている推奨寸法をご参照下さい。
- D2 Do not use the switch in a manner that the stem will be given stress from the side. If you push the stem from the side, the switch may be broken. ステムを横方向から押す様な使い方は避けて下さい。ステム先端に横方向から荷重が加わりますとスイッチが破壊される場合があります。
- D3. Press the center of the stem. Click feel may be changed, if you press the edge. This is because the center will be displaced, depending on the hinge structure or cumulative tolerances. When you use the hinge structure, take special care so that the keytop point to press the switch won't

ステムのセンターを押す様にして下さい。ヒンジ構造及びセット上の累積公差によるセンターズレなどステムを端押しする状態では感触が変化する場合があります ヒンジ構造の場合は、押下時ステム押し位置が移動しますので、特にご注意下さい。

- D4. This switch is designed for unit construction that it is pressed by human operation. Please avoid using this switch as mechanical detecting function. In case such detecting function is required, please consult with our detector switch section.
  当スイッチは、直接人の操作を介してスイッチを押す構造にてご使用下さい。メカ的な検出機能へのご使用は、避けて下さい。
  検出機能には弊社検出スイッチをご使用下さい。
- D5.The switch will be broken, if you give larger stress than specified. Take most care not to let the switch be given larger stress than specified. (Refer to the strength of the stooper.)

スイッチ操作時に規定以上の荷重が加わるとスイッチが破損する場合が有ります。スイッチに規定荷重以上の力が加わらない様にご注意下さい。 (ストッパー強度参照)

DOCUMENT No. TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS PAGE 製品仕様書 6/6

- E. Using environment 使用環境
- E1. Foreign matter invaded from outside. 外部浸入物

Since this switch does not have sealed structure, it may have contact failure caused by the dust from outside up to the environment 当スイッチは密閉構造ではありませんので、使用環境によっては塵埃が内部に侵入し、接点障害を起こす場合があります。

When you use this switch, precaution must be taken against the dust.

The followings are examples of dust invasion:

ご使用の際はスイッチに異物が侵入しないようにご注意ください。

以下に塵埃侵入例を示します。ご参考にして下さい。

Debris from the cut or hole of PCB in process, or wastes from the PCB protection material (e.g. newspaper, foamed polystyrene etc.) invaded the switch.

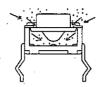
工程内における基板切断面や穴から発生するクズやPCB保護材(新聞紙、発泡スチロール等)から出るゴミがスイッチに侵入した。

②Flux or powdered flux produced by stacking PCB's or excess foaming invaded the switch.

基板重ねによりフラックス粉末がスイッチに侵入した。

When you need higher dust-proof, make selection among the switches of dust-proof types in our catalog.

より高い防塵性が必要な場合は、当社カタログより防塵タイプのスイッチ を選定しご使用願います。 Dusty environment 應埃環境



"→"Indicates the route of invasion.

"→"は侵入経路を示します。

E2. In case this product is always used around a sulfurate hot spring where sulfide gas is generated or in a place where exhaust gas from automobiles exists, take most care due to the switch performance might be affected.

硫黄系温泉地等常時ガスが発生する場所や自動車等の排気ガスの発生する場所で常時使用する場合、当製品の性能に影響を及ぼすおそれがありますので十分に ご注意下さい。

- E3. Follow the directions if you have parts/materials described below within the module where the switch is installed.
  - 同一セット内に以下の様な部材に関しましては以下の点にご注意願います。
    - For parts, rubber materials, adhesive agents, plywood, packing materials and lubricant used for the mechanical part of the device, do not use those ones that may generate gas of sulfurization or oxidization.

部品、ゴム材料、接着剤、合板、機器の梱包材、機器内の駆動部に使用される潤滑剤については、硫化、酸化ガスを発生しないものを採用してください。
When you use silicon rubber, grease, adhesive agents and oil, use those that will not generate low molecular siloxane gas. The low molecular

siloxane gas may form silicon dioxide coat on the SW contact part, resulting in the contact failure.
シリコン系ゴム、グリース、接着剤、オイルを使用される場合は、低分子シロキサンガスを発生しないものを使用してください。低分子シロキサンガスが発生しますとSW接点部に2酸化珪素の被膜を形成して接点障害を引き起こす場合があります。

When you apply chemical agents such as coating agents to the products, please let us know beforehand. 製品のコーティング剤等の薬品を付着させる場合は、別途ご相談ください。

- E4. Do not use this switch in the atmosphere with high humidity or with bedewing probability, because such atmosphere may cause leak among terminals. 高湿度環境下、又は結露する可能性がある環境では、端子間の電流リークが発生する可能性が有りますので本スイッチはご使用にならないでください。
- F. Storage method. 保管方法
- F1. If you don't use the product immediately, store it as delivered in the following environment with neither direct sunshine nor corrosive gas and in normal temperatures. However, it is recommended that you should use it as soon as possible before six months pass. 製品は納入形態のまま常温、常湿で直射日光の当たらず腐食性ガスが発生しない場所に保管し納入から6ヶ月以内を限度として出来るだけ早くご使用ください。
- F2. After you break the seal, you should put the remaining in a plastic bag to separate it from the outside and store it in the same environment mentioned above. You should use it up as soon as possible. 開封後はポリフクロで外気との遮断を図り上記と同じ環境下で保管しすみやかにご使用下さい。
- F3. Do not stack too many switches for strafe.

過剰な積み重ねは行わないで下さい。

- G. Others. その他
- G1. This specification will be invalid one year after it is issued, if you don't return it or don't place an order. 本仕様書は発行日より1年間を経過して、ご返却又はご発注の無い場合は、無効とさせていただきます。
- G2. Please understand that the specifications other than electric and mechanical characteristics and outside dimensions may be changed at our own discretion.

電気的、機械的特性、外観寸法および取付寸法以外につきましては、当社の都合により変更させて頂く事が有りますので、あらかじめ御了承下さい。

- G3. Never use the product beyond the rating It may catch fire. If you think that the product may be used beyond the rating due to some abnormal conditions, you must take certain protective measures, such as a protective circuit to shut down the current 定格を超えての使用は火災発生のおそれがありますので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れがある場合は保護回路等で電流遮断等の対策をして下さい。
- G4. The flammability grade of the plastic used for this product is "94HB" by the UL Standard (slow burning). Therefore, either refrain from using it in the place where it can catch fire, or take measures to preclude catching fire.

  本製品に使用している樹脂等の燃焼グレードはUL規格の"94HB"(遅燃性グレード)相当を使用しております。 つきましては頻焼の恐れがある場所での使用を禁止するか、類焼防止対策をお願いします。
- G5. Though we are confident in switch quality, we cannot deny the possibility that they could fail due to short or open circuit. Therefore, if you use a switch for a product requiring higher safety level, we would like you to verify in advance what effects your module would receive in case the switch alone should fail. And secure safety as a whole system by introducing the fail-safe design, i.e. a protection network. スイッチの品質には万全を尽くしていますが故障モードとしてショート、オープンの発生が皆無とは言えません。安全性が重視されるセットの設計に際しては、スイッチの単品故障に対してセットとしての影響を事前にご検討頂き、保護回路等のフェールセーブ設計のご検討を十分に行い安全を確保して頂きますようにお願いします。